【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和6年9月11日(2024.9.11)

【国際公開番号】WO2023/127385
【出願番号】特願2023-570747(P2023-570747)
【国際特許分類】
H01L 21/82(2006.01)
H01L 21/8238(2006.01)
H01L 25/07(2006.01)
【FI】
H01L 21/82 W
H01L 21/82 L
H01L 21/82 B
H01L 27/092 F
H01L 25/08 C

【手続補正書】
【提出日】令和6年5月24日(2024.5.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４５】
以上のように本実施形態によると、第１半導体チップ１０１と第２半導体チップ１０２が積層されており、第１半導体チップ１０１の裏面と第２半導体チップ１０２の主面とが対向している。第１半導体チップ１０１は、埋込配線層に形成され、Ｘ方向に延びており、Ｙ方向において隣り合う電源配線１１，１２を備えており、また、電源配線１１，１２とチップ裏面との間に設けられたコンタクト４１，４２と、信号配線とチップ裏面との間に設けられたコンタクト５１，５２とを備えている。そして、コンタクト５１，５２は、平面視で、Ｙ方向において電源配線１１と重なりを有しており、かつ、Ｘ方向において、コンタクト４１，４２と異なる位置にある。また、コンタクト５１，５２は、平面視で、Ｙ方向においてコンタクト４１と重なりを有しており、かつ、Ｘ方向において、コンタクト４１，４２と異なる位置にある。これにより、コンタクト５１，５２とコンタクト４１，４２との間隔を十分に確保することができるので、コンタクト５１，５２の平面サイズを大きくしても、製造を容易にでき、信頼性を確保することできる。